

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60317-2

1990

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
1999-10

Amendement 2

**Spécifications pour types particuliers de fils
de bobinage –**

Partie 2:

**Fil de section circulaire en cuivre émaillé
avec polyuréthane brasable, classe 130,
avec une couche adhérente**

Amendment 2

**Specifications for particular types of
winding wires –**

Part 2:

**Solderable polyurethane enamelled round
copper wire, class 130, with a bonding layer**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

D

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
55/693/FDIS	55/720/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 14

17 Brasabilité

17.3 Diamètres nominaux des conducteurs supérieurs à 0,100 mm

Remplacer le titre et le texte existants par ce qui suit:

17.3 Diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,100 mm

La température du bain de brasure doit être de (375 ± 5) °C. La durée maximale d'immersion (en secondes) doit être le multiple du diamètre nominal du conducteur (en millimètres) donné ci-après avec un minimum de 2 s.

Grade 1B	Grade 2B
12 s/mm	16 s/mm

La surface du fil étamé doit être lisse et sans trou ni résidu d'email.

18 Adhérence par chaleur ou par solvant

Remplacer le texte existant par le nouveau texte suivant:

NOTE – Adhérence par solvant: essai nécessaire, mais qui n'est pas encore à l'étude.

18.1 Adhérence par chaleur

18.1.1 Force d'adhérence par chaleur d'un bobinage hélicoïdal

18.1.1.1 A température ambiante

Les éprouvettes doivent être préparées selon la méthode d'essai, et la température de l'étuve pour le collage doit être fixée selon accord préalable entre l'acheteur et le fournisseur pour les différents types d'émaux adhérents. La température suggérée pour l'email adhérent polyamide est de (200 ± 2) °C et la température suggérée pour l'email adhérent butyral polyvinylique est de (170 ± 2) °C.